

导热绝缘垫片 M28

Thermal Conductive Adhesive Gap Pad M28

产品概述

M28 是一款具备高导热性能的绝缘垫片，适用于较低紧固压力的元器件固定。该产品具有高导电性和高可靠性，表面平滑，具有良好的黏贴性，导热系数达 1.6W/m.k，可以有效减少低压力下的界面热阻，适用于各类电源、汽车电子产品、功率半导体器件、马达控制器、电子产品等。

由于膜厚只有约 0.13mm，产品非常轻便，更加适用于精细化微电子产品，在保证产品性能的基础上有效节省设计空间，从而提升终端产品的轻量化性能。

产品基本特性

外观 (Appearance)	金色平滑膜
功能型号 (Function Model)	M281 (卷材)
	M282 (背胶)
	M283 (模切)
材质 (Material)	橡胶
基材 (Base Material)	玻璃纤维
耐温性能 (Temperature)	-60-180°C
厚度(Thickness)	0.127mm
胶面(Glue):	单面带压敏胶/不背胶

产品性能参数

导热系数(Thermal Conductivity)	1.6W/m.k				
抗击穿电压(Dielectric Breakdown Voltage)	5500V				
硬度 (Hardness Shore A)	92				
伸长率 (Elongation)	20				
抗拉强度 (Tensile Strength)	9MPa				
介电常数 (Dielectric Constant, 1000Hz)	6.0				
电阻率 (Volume Resistivity)	10 ¹⁰ Ohm.m				
阻燃等级 (Flame Rating)	V-0				
压值 (Pressure, psi)	10	25	50	100	200
热阻 (Thermal Impedance, °C-In2/W)	0.95	0.75	0.61	0.47	0.41

产品包装及货期

卷材(Roll)	304.8 mm *76.2 m
片材(Sheet)	304.8 mm *304.8 mm 或定制尺寸
最小包装量 (MPQ)	一卷或 23.2m ²
最小订单量 (MOQ)	一卷或 23.2m ²
交货期 (L/T)	20-30 个工作日